

巻 頭 言

取締役兼執行役員
(技術統括部担当役員)

仲村 公孝



昨年は、多くの国で国政選挙が行われ、その結果として日米欧をはじめ、幅広く政権の枠組みが変化する大きな転換点を迎える年になりました。その中でも、今後の日本および世界経済の先行きにおいては、米国のトランプ政権の政策「トランプ2.0」が最大の不透明要因となっており、特に関税の引上げ幅や範囲、時期などは今後の世界経済に大きな影響を及ぼすことが推察されます。

一方、国内産業では2024年11月に「AI・半導体産業基盤強化フレーム」が発表され大幅な公的支援が打ち出され、半導体関連投資がますます活発になっています。成長ドライバーである生成AIには最先端のロジック半導体やメモリ半導体、そしてデータセンターが必要不可欠ですが、これらを製造・運用するためには莫大な電力が必要であり、各産業分野においては環境配慮型製品や先端半導体関連資材の継続的な創出・供給が必要になります。

当社は創業以来、製鉄、化学、電力、半導体など多くの産業分野のエンジニアリング・建設・メンテナンス、装置製作・ソリューションに携わらせて頂いてきました。今後も、これらの時流に乗った各産業分野のニーズにお応えすべく、DX推進による業務効率化をはじめ、事業基盤の強化や持続的成長へ向けた挑戦を進めて参ります。

本号ではその一環として、各産業分野の基盤要素技術である溶接技術を紹介するとともに、産業プラントや社会インフラで活用が大いに期待される「電流情報量診断システムT-MCMA[®]」の活用実績、および半導体関連分野で多くの実績がある剥離・洗浄・切断工程の装置群の中からダイシング後のメタルバリ除去に特化した「マルチファンクション洗浄装置TCX100」を紹介しています。また、プラント設備の点検に活用される「ドローンを用いたスクリーニング点検」を東亜非破壊検査株式会社様よりご寄稿戴いております。

是非、これらの論文・報告をご高覧頂きまして、皆様の忌憚のないご意見・ご批評を頂ければ、誠に幸甚でございます。

今後とも皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。